

红外激光划片机

红外激光划片机是针对光电子行业发展需要开发的第二代设备，主要用于单晶硅、多晶硅、非晶硅太阳能电池的划片，还可用于硅、锗、砷化钾和其他半导体衬底材料的划片与切割以及薄金属板切割打孔。

特点：

- 模块化设计，整机结构合理
- 操作方便，能长期连续工作
- 高效率高光束质量的全固态激光光源
- 激光功率大，能量连续可调
- 加工速度快，性能稳定
- 保证全加工范围内高精度
- 真空吸附和吹气功能

应用材质：

- 单晶硅、多晶硅、非晶硅
- 太阳能电池
- 薄金属板



技术指标与参数：

型号	BeamEdge-50
激光波长	532/1064nm
工作台行程	200/300mm（选配）
重复定位精度	<0.005mm
划片直径	0 ~ 140mm
划片厚度	0.1 ~ 1.5mm
划片直径误差	<±0.15mm
工作台最大速度	≤ 600mm/min
加工平面度	<±0.5°
划片速度	≤ 180mm/min（0.7mm厚的硅片）
使用环境温度	15 ~ 30℃
使用环境湿度	<60%
电力需求	220V/50Hz/16A
整机额定功率	2kW
划片机主体尺寸	1300mm×680mm×1320mm
冷却系统尺寸	750mm×400mm×750mm

